COMBAT®

BORON NITRIDE MACHINABLE CERAMICS

窒化ホウ素成型品



六方晶窒化ホウ素をホットプレスしたCOMBATは、高性能工業分野の幅広い範囲に適する、特徴的な化学的、電気的、構造的、そして熱的性質の組み合わせを示します。

COMBATの特性は、バインダーの種類と量、全体の複合物および層間の結合の種類によって異なります。サンゴバンが持つ業界最先端の技術サポートに裏打ちされた COMBATは、あらゆる分野のマシナブル素材におけるソリューションとして、お客様に合わせて仕上げた形状でお届けします。

COMBAT AX05は、バインダーを一切使用していない自己結合性の、最高純度を提供する高温用途向けCOMBATです。ほとんど全ての溶融金属に対して非濡れ性を持つ AX05 は、超高温絶縁体と高純度加工向け坩堝などの用途に推奨されています。

COMBAT M and M26は、シリカの耐湿性を窒化ホウ素固有の特性に組み合わせています。COMBAT M26がより優れた熱伝導性を提供するのに対し、 SiO_2 の量によって特殊化されたCOMBAT Mは、比べるもののない熱衝撃抵抗性を提供しています。MおよびM26 は、過酷で厳格な誘電特性を必要とする用途に最適です。

COMBAT ZSBNは、窒化ホウ素の非濡れ性をジルコニアの超耐火性と耐摩耗性に組み合わせています。多くの溶融金属に接触する用途に幅広く使用されています。

COMBAT Aは、不活化性で乾燥した環境で使用するのに最適で、硬質で密度が高いながらも易切削性の製品を作り出すために、窒化ホウ素をバインダーとして使用しています。これは、高性能の多目的用途に最適です。

COMBAT HPは、窒化ホウ素の優れた熱衝撃抵抗性とホウ酸カルシウムガラスの耐湿性を活用しています。HPは、アルミニウムやマグネシウム、亜鉛といった軽金属加工用途、特に、最高 1000°Cまでの電気絶縁体用途に最適です。

特長/利点

- 要望の形状、サイズへの易切削性
- 優れた耐熱性
- 高熱伝導性
- 低熱膨張、優れた熱衝撃抵抗性
- 高温下でも優れた電気絶縁体
- 溶融金属、スラグ、ガラスに対する高い非濡れ性
- 極めて高い耐腐食性と耐摩耗性

主な用途

- MOCVD のセッターおよび部品
- 高温向け絶縁体
- 窒化物とサイアロンの焼成用マッフルおよび坩堝
- 金属粉末噴霧用ノズル
- 双ロール鋳造機のサイドダム
- 連続鋳造ブレークリング
- ベアリング、バルブ、スペーサーなどの 高熱機械部品
- 溶融金属加工向け坩堝と型

ターゲット マーケット

- 高熱建設
- セラミック製造
- 半導体産業
- PVD コーティング
- 電子レンジ



COMBAT®

BORON NITRIDE MACHINABLE CERAMICS

代表特性

COMBAT窒化ホウ素固形

ユニット		Α		HP		AX05		М		M26		ZSBN	
結晶層		六方晶 BN		六方晶 BN		六方晶 BN>99%		BN 40% Sio ₂ 60%		BN 40% Sio ₂ 60%		BN-45% Zro ₂ -45% ほうけい酸ガラス <10%	
Binder Phase / Binder Type		酸化ホウ素		ホウ酸カルシウム		自己融着		Sio ₂		Sio ₂		ホウケイ酸塩	
色		白色		白色		白色		白色		白色		灰色	
代表的な用途		一般的な目的		卓越した耐湿性、 耐火性、絶縁耐力		極めて高い 耐腐食性、 熱伝導性、 純度		卓越した 熱衝撃抵抗性、 耐湿性、 絶縁耐力		卓越した 熱伝導性、 耐湿性、 絶縁耐力		溶融金属 用途における、 極めて高い 耐摩耗性&耐腐食性	
方向性		II	土	II	丄	II		II	丄	II	上	II	
機械的性質													
曲げ強度	MPa	94	65	59	45	22	21	103	76	62	34	144	107
縦弾性係数	GPa	47	74	40	60	17	71	94	106			71	71
RT圧縮	MPa	143	186	96		25		316.9	289.4			218.7	253.8
開放気孔率	%	2.84				19.3		6.880		6.724		1.066	
密度(g/cc min)		2		2		1.9		2.3		2.1		2.9	
硬度-ヌープ(Kg/mm²)		20		16		4						10	00
熱的特性													
25℃での熱伝導率	W/mk	30	34	27	29	78	130	12	14	11	29	24	34
熱膨張係数(10·6)													
25-400℃		3.0	3.0	0.6	0.4	-2.3	-0.7	1.5	0.2	3.0	0.4	4.1	3.4
400-800°C		2.0	1.4	1.1	0.8	-2.5	1.1	1.2	0.4	2.5	0.1	5.6	4.3
800-1200°C		1.9	1.8	1.5	0.9	1.6	0.4	1.2	0.8	3.0	0.1	7.2	5.2
1200-1600°C		5.0	4.8	2.8	2.7	0.9	0.3					4.6	3.4
1600-1900°C		7.2	6.1			0.5	0.9						
25°Cでの比熱	J/gk	0.86		0.81		0.81		0.76		0.77		0.64	
最高温度–酸化/不活性化		850°C/1200°C		850°C/1150°C		850°C/2000°C		1000°C+		1000°C+		850°C/1600°C	
電気的特性													
1MHzでの誘電率		4.6	4.2	4.3	4.0	4.0	4.0	3.4	3.7	4.5	3.8		
1MHzでの誘電正接		1.2E-03	3.4E-03	1.5E-03	2.1E-03	1.2E-03	3.0E-04	3.0E-03	3.1E-03	1.7E-03	6.7E-03		
絶縁耐力	KV/mm	88		>10		79		>10		66		>9	
RT抵抗率(ohm cm)	Ωcm	>1013	>1014	>1013	>1013	>1013	>1014	>1014	>1014	>1013	>1014	>1014	>1015

詳細については、www.saint-gobain.co.jpからご覧になるか、www.bn.saint-gobain.comをご覧ください。

サンゴバン株式会社 CM事業部

〒541-0041 大阪市中央区北浜1-1-14 北浜一丁目平和ビル 7F TEL(06)4707-1700(代表) FAX(06)4707-1701

サンゴバン株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7 TEL(03)6893-0050 FAX(03)3221-9976





www.saint-gobain.co.jp Combat は、サンゴバン セラミック マテリアルズの登録商標です。

---ここに述べられている情報、推奨事項および意見は、お客様が検討、照会および検証を行う目的のみのために提供するものであり、一部またはその全体が、当社が法的責任を負うべき保証または告知事項を構成するものとして見なされるべきではありません。本書記載の事項のいずれにおいても、ライセンスなしで特許発明を実施する許可として見なされるべきではありません。

©2011 サンゴバン セラミック マテリアルズ



SPECIALTY GRAINS AND POWDERS